

錫球晶圓研磨膠帶

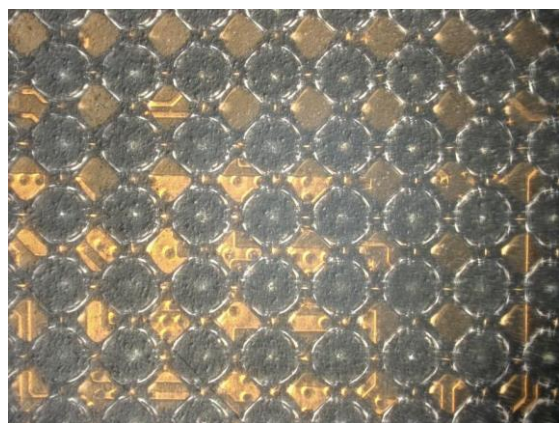
Back Grinding Tape line-up (for Bumped wafer)

錫球晶圓研磨膠帶特徵

- 對大直徑錫球晶圓保有優良的包覆性
不易造成表面凹陷(dimple)
- 易剝離設計，膠帶在剝離時降低錫球破損及殘膠的風險
- 使用PET基材，能有效抑制晶圓的翹曲

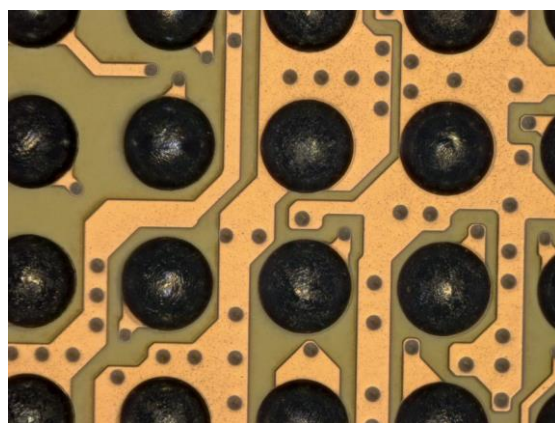
製品號碼	6351-30	6351-40	6352-30	6352-40
類型	UV curable	UV curable	Non-UV	Non-UV
厚度(μm)	270	460	270	445
對應錫球直徑(μm)	~200	~300	~200	~300

對錫球的包覆性良好



錫球高度：200 μm

無黏著劑殘留



錫球直徑：300 μm

